| | |
|---|---|
| 良品チップ選別技術開発 | |
| パイロットラインの構築状況 | |
| その他 | |

（注１０）必要に応じて各項目の記載内容を証明又は補足する書類を提出すること。

４．特定取組の内容及び実施期間

（１）特定取組の内容

（イ）　技術開発に係る計画・体制に関する事項

| 項目 | 具体的な内容について |
|---|---|
| 生産技術・生産工程の開発状況 | |
| 生産設備（搬送装置等）の開発状況 | |
| ＥＵＶ露光技術の開発状況 | |
| パイロットラインの構築状況 | |
| テストチップの試作状況 | |
| 歩留まりに係る状況 | |
| ＰＤＫ・ＩＰの開発状況 | |
| パッケージ生産技術・生産工程の開発 | |
| パッケージ設計技術の開発 | |
| 良品チップ選別技術開発 | |
| パイロットラインの構築状況 | |
| その他 | |

（注１１）技術開発に係る計画を実行する上でのリスク及びその対応策についても記載すること。
（注１２）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ロ）公募対象半導体の生産に係る事業戦略に関する事項

（注１３）獲得を見込む市場の成長性や需給見通し等を踏まえた市場獲得の可能性についても記載すること
（注１４）競合他社との比較を踏まえた顧客獲得の戦略についても記載すること。
（注１５）顧客の獲得の見込みについても記載すること。
（注１６）他企業・他機関との連携や知的財産の利活用についても記載すること。
（注１７）公募対象半導体の生産に係る事業戦略を実行する上でのリスク及びその対応策についても記載すること。
（注１８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ハ）生産設備の整備に係る計画に関する事項

（注１９）各年度における想定する生産能力の規模についても記載をすること。
（注２０）生産設備の整備に係る計画を実行する上でのリスク及びその対応策についても記載すること。
（注２１）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ニ）生産設備及び原材料等の安定的な調達に係る取組に関する事項

（注２２）関連事業者とのコミュニケーション状況、輸送経路及び輸送体制等についても記載すること。
（注２３）工業用水等の確保に係る取組についても記載すること。
（注２４）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ホ）技術者等の人材確保・育成に係る取組に関する事項

（注２５）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。
（注２６）半導体に係る人材育成に取り組む産学連携組織の加入、当該組織への参加状況についても記載すること。加えて、関係する教育機関、研究機関又は技術研究組合等と連携状況についても記載すること。

（ヘ）その他特定取組の内容に関する事項

（注２７）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（２）特定取組の実施期間

（注２８）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（３）公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国・地方公共団体その他の関係者との連携並びにその特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項

（イ）公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国・地方公共団体その他の関係者との連携に関する事項

（注２９）半導体に係る人材育成や研究開発及び実証に関する施策との連携体制について記載すること。
（注３０）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

（ロ）公募対象半導体に係る特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項

（注３１）雇用創出、投資誘発効果、関連産業や地域経済への経済波及等を記載すること。
（注３２）必要に応じて記載内容を補足する書類を提出すること。

５．特定取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

| | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|